#### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

## (11)特許出願公開番号

# 特開平7-179743

19477048

(43)公開日 平成7年(1995)7月18日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>		識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所					
C 0 8 L	69/00	LPR								
C 0 8 K	3/00	KKH								
	5/524	KKM								
C 0 8 L	67/00	LPD								
	67/02	LPE								
				審査請求	未請求 請求項の数10 OL (全 8 頁)					
(21)出願番号		<b>特願平6-249116</b>	-	(71)出願人	390006323					
					ポリプラスチックス株式会社					
(22)出願日		平成6年(1994)10	月14日		大阪府大阪市中央区安土町2丁目3番13号					
				(72)発明者	明田 智行					
(31)優先権主	E張番号	特願平5-282377			静岡県富士市大渕2865-8					
(32)優先日		平 5 (1993)11月11	<b>目</b> .	(72)発明者	石川 貴之					
	上張国	日本 (JP)			静岡県清水市興津井上町727					
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				(74)代理人	弁理士 古谷 馨 (外3名)					
		,								

## (54) 【発明の名称】 合成樹脂組成物及びその成形体

## (57)【要約】

【目的】 一般のポリエステルと液晶性ポリエステル樹脂とのプレンド樹脂組成物において、成形時に液晶性ポリエステル樹脂を繊維化させ、機械的強度等に優れた樹脂組成物を得る。

【構成】 (a) 異方性溶融相を形成しないポリエステル系樹脂99~50重量部と(b) 液晶性ポリエステル樹脂1~50重量部からなる樹脂成分100 重量部に、(c) 燐化合物を0.01~0.5 重量部配合してなる、成形時に(b) 液晶性ポリエステル樹脂が平均アスペクト比6以上に繊維化する合成樹脂組成物。

10

## 【特許請求の範囲】

(a) 異方性溶融相を形成しないポリエス 【請求項1】 テル系樹脂99~50重量部と(b) 異方性溶融相を形成し得 る液晶性ポリエステル樹脂1~50重量部からなる樹脂成 分100 重量部に、(c) 燐化合物を0.01~0.5 重量部配合 してなる、成形時に(b) 異方性溶融相を形成し得る液晶 性ポリエステル樹脂が平均アスペクト比6以上に繊維化 する合成樹脂組成物。

(a) 異方性溶融相を形成しないポリエス 【請求項2】 テル系樹脂と(c) 燐化合物との比(c) /(a) が、0.001 ~0.005 である請求項1記載の合成樹脂組成物。

(a) 異方性溶融相を形成しないポリエス 【請求項3】 テル系樹脂が、ポリカーボネート樹脂、ポリアルキレン テレフタレート樹脂及びポリアリレート樹脂の1種又は 2種である請求項1又は2記載の合成樹脂組成物。

【請求項4】 (a) 異方性溶融相を形成しないポリエス テル系樹脂が、ポリカーボネート樹脂及びポリアリレー ト樹脂の1種又は2種である請求項1又は2記載の合成 樹脂組成物。

ポリアルキレンテレフタレート樹脂が、 【請求項5】 ポリエチレンテレフタレート樹脂及び/又はポリプチレ ンテレフタレート樹脂である請求項3記載の合成樹脂組 成物。

【請求項6】 (c) 燐化合物がペンタエリスリトール型 の亜燐酸化合物である請求項1~5の何れか1項記載の 合成樹脂組成物。

【請求項7】 更に(a) 及び(b) 以外の異方性溶融相を 形成しない熱可塑性樹脂を1~90重量部配合してなる請 求項1~6の何れか1項記載の合成樹脂組成物。

【請求項8】 更に無機充填剤を1~100 重量部配合し てなる請求項1~7の何れか1項記載の合成樹脂組成

【請求項9】 請求項1~8の何れか1項記載の合成樹 脂組成物を成形してなる成形体。

【請求項10】 成形が(b) 異方性溶融相を形成し得る 液晶性ポリエステル樹脂の融点以上の温度で行われる請 求項9記載の成形体。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は異方性溶融相を形成しな 40 いポリエステル系樹脂と液晶性ポリエステル樹脂とのブ レンド樹脂組成物及びその成形体に関する。

#### [0002]

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】異方性 溶融相を形成し得る液晶性ポリエステル樹脂(LCP) は、高強度、高剛性、高耐熱性、易成形性と云った数多 くの特性を有する熱可塑性樹脂であるが、分子鎖配向方 向と垂直方向では成形収縮率や機械物性が異なり、更に 高価格と云った、商業上の不利もある。一方、ポリカー ボネート樹脂 (PC) 等の異方性溶融相を形成しないポ 50 べく鋭意探索、検討を行ったところ、特定の燐化合物を

リエステル系樹脂は、比較的安価であるが耐熱性、剛性 等の物性が液晶性ポリエステルよりも劣るという不利が ある。特に薄肉のハウジングに使用するには剛性が不足 するため、どうしても設計上肉厚にせざるを得ないので 昨今の電気、電子、通信機器分野での小型軽量化に対応 するには限界があった。そこで、LCPと異方性溶融相 を形成しないポリエステル系樹脂の利点を活かし、両者 の持つ欠点を補うためにこれらを混合して使用する試み が行われている。しかしながら、単に異方性溶融相を形 成しないポリエステル系樹脂に少量のLCPをブレンド した樹脂組成物からなる射出成形体では、LCPの高強 度、高剛性、耐熱性、易成形性と云った特性が活かされ ず、その機械的強度が著しく低下してしまう。この原因 は、LCPの高い機械物性等の発現の源は溶融加工時に 剪断応力、伸張応力を受けることによる分子配向であ り、特に成形品表層付近で分子配向するにもかかわら ず、異方性溶融相を形成しないポリエステル系樹脂と少 量のLCPを単にプレンドしただけの樹脂組成物では、 表層以外は異方性溶融相を形成しないポリエステル系樹 20 脂をマトリックスとしてほとんどのLCPが球状に分散 しただけの補強効果のない形態をしているためである。 即ち、成形品内部においてLCPが繊維状になることに よって始めてLCPが繊維状形態の長さ方向に分子配向 し、補強効果のある形態となるのである。又、LCPの 割合を多くして異方性溶融相を形成しないポリエステル 系樹脂を少なくすると、今度はLCPがマトリックスに なり、PCが島状に分散した形態になるが、これでは異 方性溶融相を形成しないポリエステル系樹脂の利点を活 かすことが出来ず、利用価値が少ない。そこで、特開平 5-70700 号公報や特開平5-112709号公報に記載され ているように、まずLCPとPC等の熱可塑性樹脂が共 に溶融する温度において延伸しながら押出すことによっ て、予めLCPがアスペクト比の大きな繊維状で存在す るように成形用素材を作り、成形品を成形する際には、 その成形用素材をLCPが溶融しないでPC等の熱可塑 性樹脂のみが溶融する温度で成形することによって補強 効果を持つ繊維状LCPを含有する成形体を作製する方 法が考えられた。しかし、これらにおいては、予め延伸 しながら押出してLCPを繊維状に配向した状態にして おくか、初めから成形体を作製する場合には、型に樹脂 組成物を充填する際にかなりの剪断力をかけ、LCPを 繊維状にさせなければならない。前者の場合には、流動 性が悪くなったり、成形条件が狭くなることが考えら れ、後者の場合には、成形品形状にかなり影響されると 共に、場所により充分に繊維状にならないため強度不足

#### [0003]

となる可能性がある。

【課題を解決するための手段】本発明者等は上記問題点 に鑑み、成形材料として優れた特性を有する素材を得る

配合することにより、予めLCPを繊維状に配向するように押出しておく必要がなく、成形時にLCPも充分流動する温度で成形すれば容易にLCPが繊維化して補強効果を発現し、成形品の機械的強度及び耐熱性、易成形性等についてもLCPに近づく高い値が得られる樹脂組成物を見出し、本発明を完成するに到った。即ち、本発明は、(a) 異方性溶融相を形成しないポリエステル系樹脂99~50重量部と(b) 異方性溶融相を形成し得る液晶性ポリエステル樹脂1~50重量部からなる樹脂成分100重量部に、(c) 燐化合物を0.01~0.5 重量部配合してな 10る、成形時に(b) 異方性溶融相を形成し得る液晶性ポリエステル樹脂が平均アスペクト比6以上に繊維化する合成樹脂組成物である。

【0004】以下、本発明の構成を詳細に説明する。本 発明に用いられる(b) 液晶性ポリエステルとは、溶融加 工性ポリエステルで、溶融状態でポリマー分子鎖が規則 的な平行配列をとる性質を有している。分子がこのよう に配列した状態をしばしば液晶状態または液晶性物質の ネマチック相という。このようなポリマー分子は、一般 に細長く、偏平で、分子の長軸に沿ってかなり剛性が高 20 く、普通は同軸または平行のいずれかの関係にある複数 の連鎖伸長結合を有しているようなポリマーからなる。 異方性溶融相の性質は、直交偏光子を利用した慣用の偏 光検査法により確認することができる。より具体的に は、異方性溶融相の確認は、Leitz 偏光顕微鏡を使用 し、Leitz ホットステージにのせた溶融試料を窒素雰囲 気下で40倍の倍率で観察することにより実施できる。本 発明のポリマーは直交偏光子の間で検査したときにたと え溶融静止状態であっても偏光は透過し、光学的に異方 性を示す。本発明に使用するのに適した液晶性ポリマー は、一般溶剤には実質的に不溶である傾向を示し、した がって溶液加工には不向きである。しかし、既に述べた ように、これらのポリマーは普通の溶融加工法により容 易に加工することができる。本発明で用いられる液晶性 ポリマーは、芳香族ポリエステル及び芳香族ポリエステ ルアミドが好ましく、芳香族ポリエステル及び芳香族ポ リエステルアミドを同一分子鎖中に部分的に含むポリエ ステルも好ましい例である。

【0005】特に好ましくは、芳香族ヒドロキシルカルポン酸、芳香族ヒドロキシルアミン、芳香族ジアミンの 40群から選ばれた少なくとも1種以上の化合物を構成成分として有する液晶性芳香族ポリエステル、液晶性芳香族ポリエステルアミドである。より具体的には、

- 1)主として芳香族ヒドロキシカルボン酸及びその誘導体の1種又は2種以上からなるポリエステル
- 2)主として
- a) 芳香族ヒドロキシカルボン酸及びその誘導体の1種 又は2種以上と
- b) 芳香族ジカルボン酸、脂環族ジカルボン酸及びその 誘導体の1種又は2種以上と

c) 芳香族ジオール、脂環族ジオール、脂肪族ジオール 及びその誘導体の少なくとも1種又は2種以上とからなるポリエステル

#### 3)主として

- a) 芳香族ヒドロキシカルボン酸及びその誘導体の1種 又は2種以上と
- b) 芳香族ヒドロキシアミン、芳香族ジアミン及びその 誘導体の1種又は2種以上と
- c) 芳香族ジカルボン酸、脂環族ジカルボン酸及びその 10 誘導体の1種又は2種以上とからなるポリエステルアミ ド

#### 4)主として

- a) 芳香族ヒドロキシカルボン酸及びその誘導体の1種 又は2種以上と
- b) 芳香族ヒドロキシアミン、芳香族ジアミン及びその 誘導体の1種又は2種以上と
- c) 芳香族ジカルボン酸、脂環族ジカルボン酸及びその 誘導体の1種又は2種以上と
- d) 芳香族ジオール、脂環族ジオール、脂肪族ジオール及びその誘導体の少なくとも1種又は2種以上とからなるポリエステルアミド

が挙げられる。更に上記の構成成分に必要に応じ分子量調整剤を併用しても良い。本発明の液晶性ポリエステルを構成する具体的化合物の好ましい例は、2,6ーナフタレンジカルポン酸、2,6ージヒドロキシナフタレン、1,4ージヒドロキシナフタレン及び6ーヒドロキシー2ーナフト工酸等のナフタレン化合物、4,4'ージフェニルジカルボン酸、4,4'ージヒドロキシピフェニル等のピフェニル化合物、pーヒドロキシ安息香酸、テレフタル酸、30ハイドロキノン、pーアミノフェノール及びpーフェニレンジアミン等のパラ位置換のベンゼン化合物及びそれらの核置換ベンゼン化合物(置換基は塩素、臭素、メチ

らの核置換ベンゼン化合物(置換基は塩素、臭素、メチル、フェニル、1-フェニルエチルより選ばれる)、イソフタル酸、レゾルシン等のメタ位置換のベンゼン化合物である。その具体的化合物の好ましい例は、2.6-ナフタレンジカルボン酸、2.6-ジヒドロキシナフタレン、1,4-ジヒドロキシナフタレン及び6-ヒドロキシー2-ナフト工酸等のナフタレン化合物、4,4'-ジフェニルジカルボン酸、4,4'-ジヒドロキシピフェニル等のピフェニル化合物、下記一般式(I)、(II)又は(III)で表される化合物:

[0006]

【化1】

$$HO \longrightarrow N \xrightarrow{CO} OH (I)$$

【0007】(但し、X:アルキレン(C<sub>1</sub>~C<sub>1</sub>)、アルキ リデン、-0- 、-SO-、-SO2- 、-S- 、-CO-より選ばれる

 $Y:-(CH_2)_n$   $(n=1\sim4)$ ,  $-0(CH_2)_n0$   $(n=1\sim4)$  £0 選ばれる基)

又、本発明に使用される液晶性ポリエステルは、上述の 構成成分の他に同一分子鎖中に部分的に異方性溶融相を 示さないポリアルキレンテレフタレートであってもよ い。この場合のアルキル基の炭素数は2乃至4である。 上述の構成成分の内、ナフタレン化合物、ピフェニル化 合物、パラ位置換ペンゼン化合物より選ばれる1種若し くは2種以上の化合物を必須の構成成分として含むもの 20 使用できる。 が更に好ましい例である。又、p-位置換ベンゼン化合 物の内、pーヒドロキシ安息香酸、メチルハイドロキノ ン及び1-フェニルエチルハイドロキノンは特に好まし い例である。構成成分となるエステル形成性の官能基を 有する化合物の具体例及び本発明で用いられるのに好ま しい異方性溶融相を形成するポリエステルの具体例につ いては特公昭63-36633 号公報に記載されている。上記 の芳香族ポリエステル及びポリエステルアミドはまた、 60℃でペンタフルオロフェノールに0.1 重量%濃度で溶 解したときに、少なくとも約2.0d1/g、たとえば約2.0 ~10.0dl/gの対数粘度(I.V.)を一般に示す。本発明にお けるブレンド組成中のLCPの量は、(a) 異方性溶融相 を形成しないポリエステル系樹脂との合計100 重量部 中、1~50重量部である。

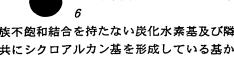
【0008】また、本発明に使用されるもう一つの成分 である(a) 異方性溶融相を形成しないポリエステル系樹 脂は、分子の主鎖にエステル結合を有する熱可塑性の高 分子化合物であり、例えばポリカーボネート樹脂、ポリ アルキレンテレフタレート樹脂、ポリアリレート樹脂等 を挙げることができる。ポリカーポネート樹脂は、一般 40 に式(IV)の繰り返し単位を有する。

[0009]

[化2]

$$\left\{
\begin{array}{c}
R - \stackrel{P}{\downarrow} - R - 0 - \stackrel{C}{\downarrow} - 0 \\
0 & 0
\end{array}
\right\}_{n}$$
(IV)

【0010】ここで式中のRは、例えばナフチレン、フ ェニレン、ハロゲン置換フェニレン及びアルキル基置換 フェニレンのような、芳香族基から選ばれ、P とQ は各 50



々水素、脂肪族不飽和結合を持たない炭化水素基及び隣 接炭素原子と共にシクロアルカン基を形成している基か らなる群より選ばれる。ただし、P とQ 中の炭素原子の 総数は12以下である。

【0011】又、ポリアルキレンテレフタレート樹脂 は、テレフタル酸又はそのエステル形成性誘導体と炭素 数2~4のアルキレングリコール又はそのエステル形成 性誘導体を重縮合して得られるポリエステルであり、ポ リエチレンテレフタレート樹脂、ポリブチレンテレフタ 10 レート樹脂等を挙げることができる。また、第三成分と して、イソフタル酸、シクロヘキサンカルボン酸、アジ ピン酸、ドデカン二酸等のジカルボン酸及びこれらのア ルキル、アルコキシ又はハロゲン置換体、エチレングリ コール、プタンジオール、トリエチレングリコール、ジ エトキシ化ビスフェノールA等のジヒドロキシ化合物及 びこれらのアルキル、アルコキシ又はハロゲン置換体、 ヒドロキシ安息香酸、ヒドロキシナフト工酸等のヒドロ キシカルボン酸及びこれらのアルキル、アルコキシ又は ハロゲン置換体を1~40モル%程度導入した共重合体も

【0012】又、ポリアリレート樹脂は、テレフタル酸 とイソフタル酸又はそのエステル形成性誘導体の混合物 と一般式(V)

[0013]

【化3】

$$HO \xrightarrow{R_1} R_2 \xrightarrow{R_1 \cdot R_2} OH \qquad (V)$$

【0014】で表されるピスフェノール類〔但し、-X-は、-0- 、-S- 、-SO<sub>2</sub>- 、-CO-、アルキレン基あるいは アルキリデン基(もし必要ならばアルキレン基あるいは アルキリデン基は1あるいはそれ以上の炭化水素基、ハー ロゲン原子あるいはハロゲン化炭化水素基で置換されて いても差し支えない)よりなる群から選ばれ、Rι、R₂、 R<sub>3</sub>、R<sub>4</sub>、R<sub>1</sub>′、R<sub>2</sub>′、R<sub>3</sub>′、R<sub>4</sub>′は水素原子、ハロゲン 原子および炭化水素基からなる群から選ばれる〕とから 得られる芳香族ポリエステル共重合体である。

【0015】本発明の(a) 異方性溶融相を形成しないポ リエステル系樹脂としては、LCPと溶融混練されるこ とから、耐熱性の面でポリカーボネート樹脂、ポリアリ レート樹脂が好ましく用いられる。

【0016】又、本発明では、更に(a) 及び(b) 以外の 異方性溶融相を形成しない熱可塑性樹脂を1~90重量部 配合することができる。この熱可塑性樹脂の例を示せ ば、ポリエチレン、ポリプロピレン、エチレンープロピ レン共重合体、エチレン-酢酸ビニル共重合体、ポリア ミド、ポリアセタール、ポリスチレン、スチレンープタ ジエン共重合体、スチレンーブタジエンーアクリロニト リル共重合体(またはそのエステル共重合体)、スチレ

40

ンーアクリロニトリル共重合体等のスチレン系樹脂、ポ リウレタン、弗素樹脂、ポリフェニレンオキシド、ポリ フェニレンサルファイド、ポリプタジエン、ブチルゴ ム、シリコーン樹脂、オレフィン系熱可塑性エラストマ ー (例えばEPDMまたはアイオノマー)、スチレン系 熱可塑性エラストマー(例えばSBSまたはSEB S)、ウレタン系熱可塑性エラストマー、ポリエステル 系熱可塑性エラストマー、ポリアミド系熱可塑性エラス トマー、ポリエーテル系熱可塑性エラストマー、ポリア クリレートを主とする多層グラフト共重合体等あるいは これらの変性体である。この中でも特に好ましいもの は、ポリエステル系樹脂と比較的相溶性の良いスチレン 系樹脂、ポリフェニレンオキシドである。

【0017】更に、本発明の目的である成形時にLCP を平均アスペクト比6以上に繊維化するためには、(c) 燐化合物を添加することが必要である。この燐化合物と しては、燐化物類、燐酸化合物類、亜燐酸化合物類等が 挙げられ、例えばテトラキス(2,4 -ジーt-ブチルフ ェニル) -4,4'-ピフェニレンフォスフォナイト、ピス (2,6 -ジーtープチルー4-メチルフェニル) ペンタ エリスリトールージフォスファイト、ビス(2,4,6 ージ - t - プチルフェニル) ペンタエリスリトールージフォ スファイト、トリス(2,4 -ジーt-プチルフェニル) フォスファイト等が例示されるが、亜燐酸化合物のもの が好ましく、特にペンタエリスリトール型の亜燐酸化合 物が好ましい。本発明においては、(c) 燐化合物を添加 することにより、樹脂成分の1つであるLCPが低い剪 断速度領域でも容易に繊維化するため、成形時の樹脂流 速が遅くても薄肉部はもとより厚肉部の表層からかなり 内部までLCPの繊維化した層が形成され、高強度、高 弾性率を発現することができる。この燐化合物の配合量 は、(a) と(b) の合計100 重量部に対して0.01~0.5 重 **量部が好ましく、特に0.05~0.3 重量部配合するのが好** ましい。配合量が0.01重量部未満であると通常の成形で はLCPを平均アスペクト比6以上に繊維化する事が出 来ず、0.5 重量部を越えて配合すると配合した燐化合物 のガスが大量に発生し、かえって機械的強度や成形性を 損なうことになる。特に、(a) 異方性溶融相を形成しな いポリエステル系樹脂と(c) 燐化合物との比(c) /(a) が、0.001~0.005 であることが好ましい。(c) 燐化合 物の比率がこの範囲であると、LCPの樹脂化が非常に 容易であり、成形条件、成形品の形状に関係なく繊維化 することができる。

【0018】次に本発明のプレンド組成物成形品には、 使用目的に応じて各種の繊維状、粉粒状、板状の無機の 充填剤を配合することが出来る。繊維状充填剤として は、ガラス繊維、アスベスト繊維、シリカ繊維、シリカ ・アルミナ繊維、アルミナ繊維、ジルコニア繊維、窒化 硼素繊維、窒化珪素繊維、硼素繊維、チタン酸カリウム

鍮等の金属の繊維状物などの無機質繊維状物質が挙げら れる。一方、粉粒状充填剤としては、カーボンブラッ ク、黒鉛、シリカ、石英粉末、ガラスピーズ、ミルドガ ラスファイバー、ガラスバルーン、ガラス粉、珪酸カル シウム、珪酸アルミニウム、カオリン、タルク、クレ 一、珪藻土、ウォラストナイトの如き珪酸塩、酸化鉄、 酸化チタン、酸化亜鉛、三酸化アンチモン、アルミナの 如き金属の酸化物、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム の如き金属の炭酸塩、硫酸カルシウム、硫酸バリウムの 如き金属の硫酸塩、その他フェライト、炭化珪素、窒化 珪素、窒化硼素、各種金属粉末等が挙げられる。また、 板状充填剤としては、マイカ、ガラスフレーク、各種の 金属箔等が挙げられる。これらの無機充填剤は一種又は 二種以上併用することが出来る。また本発明に用いられ る無機充填剤は、所望される物性によっては公知の表面 処理剤を併用することが可能である。例を示せば、エポ キシ系化合物、イソシアネート系化合物、チタネート系 化合物、シラン系化合物等の官能性化合物である。好ま しくは、エポキシ系化合物またはポリアミド系化合物な どアミノ系化合物以外の化合物で処理したものが良い。 これらの充填剤はあらかじめ表面処理を施して用いる か、又は材料の調製の際同時に添加しても良い。ここ で、無機充填剤の配合量は組成物全量に対し1~50重量 %が好ましい。

【0019】また、難燃剤を配合し、難燃化することも 可能であり、難燃剤としては、有機ハロゲン化合物等が 用いられるが、特に芳香族臭素化合物が好ましく、また 難燃助剤としては、三酸化アンチモン、ハロゲン化アン チモン、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム等の 金属酸化物や水酸化物等が用いられる。

【0020】尚、この樹脂組成物は、成形品内部におい てLCPが平均アスペクト比6以上の繊維状になってい るのが好ましく、特に平均アスペクト比8以上が好まし い。平均アスペクト比が6未満では、この樹脂組成物の 特徴である高強度、高弾性率が得られず、特に軽量化、 小型化のための薄肉成形品では充分な剛性が得られな 41

【0021】本発明の組成物は、一般に合成樹脂組成物 の調製に用いられる設備と方法により調製することがで きる。例えば、必要な成分を混合し、一軸又は二軸の押 出機を使用し、混練押出して成形用ペレットを調製し、 しかる後成形する方法、一旦組成の異なるペレットを調 製し、そのペレットを所定量混合して成形に供し、成形 後に目的組成の成形品を得る方法等が挙げられる。即 ち、本発明は成形時にLCPを繊維化するのであり、成 形前の組成物の調製法は何れの方法でもよい。尚、PC に含まれるLCPは、成形時の剪断力によって流動する 温度、特にLCPの融点以上の温度で成形するのが好ま しい。LCPの融点以上の温度であれば、LCPの剪断 繊維、更にステンレス、アルミニウム、チタン、銅、真 50 カによって容易に流動するという特性が生かされ、剪断

特開平 7 10

力によって容易に繊維化する。

[0022]

【実施例】以下、実施例により本発明を更に具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。 実施例1

PC (三菱瓦斯化学 (株) 製、ユーピロンS 3 0 0 0 ) (株) と後記する構成単位からなるL C P - A との混合比が リンチョ: 1 の樹脂成分に対して、亜燐酸エステル [ピス (2, 2, 2) を 6 ージー t ープチルー4ーメチルフェニル) ペンタエリ と同様スリトールージホスファイト] 0.1 重量部を配合し、30 10 示す。mmの 2 軸押出機にて樹脂温度250 ℃で溶融混練し、ペレット化した。次いで、該ペレットを射出成形にて樹脂温 P C の 度250 ℃で試験片に成形し、機械的物性、溶融粘度、L と P E を 250 ℃で試験片に成形し、機械的物性、溶融粘度、L を 2 を 250 ℃で試験片に成形し、機械的物性、溶融粘度、L を 2 を 250 ℃で試験片に成形し、機械的物性、溶融粘度、L を 250 ℃で試験片に成形し、 250 ℃では、 250

【曲げ弾性率】ASTM D 790に従い、1/16インチの厚さの試験片を用いて曲げ弾性率  $(kg/cm^2)$ を測定した。

【アイゾット衝撃強度】ASTM D 256に従い、ノッチ付きの衝撃強度(kgf・cm/cm)を測定した。

【LCPの平均アスペクト比(長さ/太さ)】曲げ弾性 20 率の測定で用いた試験片を流動方向に平行な面が出るように切削した後、断面を鏡綿研磨し、その表面を電子顕微鏡により観察して評価した。即ち、任意に選んだ繊維化しているLCP50本の長さ/太さを測定して平均値を出した。尚、長さについては、表面上で観察できる長さを測定した。評価基準は以下の通りとした。

平均アスペクト比6以上 〇

平均アスペクト比6未満 ×

[溶融粘度] 東洋精機社製キャピログラフにて、測定温度;成形時の温度、剪断速度;1000sec<sup>-1</sup>の条件で測定 30 した。

### 実施例2~3

押出温度及び成形温度を変化させた以外は実施例1と同様に試験片を成形し、評価した。評価結果を表1に示す。

## 実施例4~5

PCとLCP-Aとの混合比及び亜燐酸エステルの配合 量を変化させた以外は実施例3と同様に試験片を成形 し、評価した。評価結果を表1に示す。

#### 比較例1

亜燐酸エステルを配合しない以外は実施例3と同様に試験片を成形し、評価した。評価結果を表1に示す。

#### 比較例2~3

PCとLCP-Aとの混合比を変化させた以外は比較例 1と同様に試験片を成形し、評価した。評価結果を表1 に示す。

#### 比較例4~5

PCのペレット或いはLCP-Aのペレットを用いて、 比較例1と同様に試験片を成形し、評価した。評価結果 を表1に示す。

【0023】実施例6~8

PCの代わりに、ポリアリレート (PAR) (ユニチカ (株) 製、Uポリマー: U-1000) 又はポリブチレンテレフタレート (PBT) (ポリプラスチックス (株) 製、ジュラネックス: #2002) 又はポリエチレンテレフタレート (PET) (鐘淵化学工業 (株) 製、ベルベット: DFG-1) を用いた以外は実施例5と同様に試験片を成形し、評価した。評価結果を表2に示す

#### 実施例9~11

PCの代わりに、PCとPAR、PCとPBT、PBTとPETとの混合物(混合比=5:2)を用いた以外は 実施例5と同様に試験片を成形し、評価した。評価結果 を表2に示す。

#### 実施例12~15

PCの代わりに、PCとABS(ダイセル化学工業 (株)製、セピアン-V:#680)、PARとAB S、PBTとABS、PBTとPPE(GEPJ社製ノ リル:731J)との混合物(混合比=5:2)を用い た以外は実施例5と同様に試験片を成形し、評価した。 評価結果を表2に示す。

#### 【0024】比較例6~7

亜燐酸エステルを配合しない以外は実施例6又は7と同様に試験片を成形し、評価した。評価結果を表3に示す。

#### 比較例8~10

亜燐酸エステルを配合しない以外は実施例  $9\sim11$ と同様に試験片を成形し、評価した。評価結果を表 3 に示す。

#### 0 比較例11~13

亜燐酸エステルを配合しない以外は実施例12~14と同様 に試験片を成形し、評価した。評価結果を表3に示す。

#### 【0025】実施例16~19

PC、LCP-A、亜燐酸エステル及び無機充填剤を表 4に示す組成で配合し、前記実施例と同様に試験片を成 形し、評価した。評価結果を表4に示す。

#### 実施例20~21

PC、後記する構成単位からなるLCP-B、亜燐酸エステル及び無機充填剤を表4に示す組成で配合し、前記 40 実施例と同様に試験片を成形し、評価した。評価結果を表4に示す。

#### 比較例14~16

PC、LCP-A及び無機充填剤を表4に示す組成で配合し、前記実施例と同様に試験片を成形し、評価した。 評価結果を表4に示す。尚、実施例で使用した液晶性ポリエステル樹脂は、下記の構成単位を有するものである。

[0026]

【化4】

11

12

(以上の数字はモル比)

[0027]

\*10\*【表1】

	実施例(	実時例2	実施例 3	実施例 4	実施例 5	比較例1	比較例 2	比較例3	比較例4	比較例 5
樹脂成分 PC (重量部)	80	80	90	80	70	90	80	70	100	_
LCP-A (重量部)	10	10	10	20	30	10	20	30		100
亜燐酸エステルA (重量部)	C. 1	0. 1	0.1	0.2	0.3		_	_	_	
LCPの融点 (で)	280	280	280	280	280	280	280	280		280
押し出し温度 (*C)	250	250	300	300	300	300	800	300	_	_
成形温度 (*C)	250	300	300	300	300	300	300	300	250	300
射出速度(mm/s)	58. 3	58.3	58.3	58.3	58.3	58.3	58. 3	58. 3	20.8	20.8
100の平均73ペ 外比(6以上/〇)	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×
曲げ弾性率(kg/cm²)1/32	26000	40000	39000	51000	66000	30000	32000	31000	25000	150000
アイブットW/N(kg-cm/cm)	20.2	35. 3	32.5	12.5	&.8	2.6	1.9	1.8	12.6	44.2
裕歐枯度(poise) at成形温度	8649	1856	1725	1341	1089	2488	3093	4016	9574	- 609

[0028]

※ ※ 【表2】

			実統例 6	実施例7	実施例8	実施例 9	実施例10	实施例11	実施例12	实施例13	実統例14	庚旋例15
樹脂成分	PC	(重量部)	_	_		50	50	_	50	_	_	
	PAR	(重量部)	70	_	–	20	_	_	_	50	-	
	PBT	(重量部)	-	70		<b> </b>	20	50	<u> </u>	_	50	50
	PET	(重量部)	-	-	70	_	_	20	_	_	<u> </u>	
	ABS	(重量部)	-	-	-	<u> </u>	-	-	20	20	20	_
	PPE	(重量部)	-	-	_		-	<b> </b>		_	-	20
	LCP-A	(重量部)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
亜燐酸エス	ステルA	(重量部)	0.3	0, 3	0, 3	0.3	0.3	0.3	0. 3	0.3	0.3	0.3
LCPOR	É.É. (°C)		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
押し出しさ	(°C)		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
成形温度	(°C)		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
射出速度(	m/s)		58.3	58. 3	58. 3	58. 3	58. 3	58. 3	58, 3	58.3	58. 3	58.3
LCPの平均73ペ 外比(6以上/〇)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
曲げ弾性率(kg/on²)1/32"		57000	63000	60000	56000	67000	54000	53000	61000	52000	56000	
アイゾットW/N(kg-cm/cm)			30.3	27.5	22.3	27.8	11.5	16. 1	35. 2	22.4	18. 0	20.5
溶配粘度(	poise) at形	形温度	2297	1865	1765	2318	1754	1903	2231	2336	2400	1957

			比較例6	比較例7	比較例8	比較例 9	<b>比較例10</b>	比較例11	<b>比較</b> 例12	比較例13
樹脂成分	PC	(重量部)	_		50	50	_	50	_	
	PAR	(重量部)	70	_	20	_	-	_	50	_
	PBT	(電量部)		70		20	50		_	50
	PET	(重量部)	-	-	-	-	20			
	ABS	(重量部)		-	_			20	20	20
	PPE	(重量部)	-	_	_	_	_			
	LCP-A	A(重量部)	30	30	30	30	30	30	30	30
亜燐酸エス	ステルA	(重量部)	-		_	-	_		_	_
<b>LCPの</b> 層	t点 (°C)		280	280	280	280	280	280	280	280
押し出し	渡 (℃)		300	300	300	300	300	300	300	300
成形温度	(°C)		300	300	300	300	300	300	300	300
射出速度(	mn/s)		58. 3	58. 3	58.3	58. 3	58, 3	58. 3	58.3	58. 3
LCPの平均	なり比(	6以上/〇)	×	×	×	×	×	×	×	×
曲げ弾性革	2(kg/cm²)1.	/32"	27000	27700	30000	32000	37000	29000	23000	24300
アイゾット	W/N(kg	-cav/cm)	3.5	1.5	2. 3	5. 2	1.6	6. 1	5. 2	1.5
溶融粘度(	poise) at局	形温度	5427	2765	5765	2574	3054	4073	5431	4632
			F				ļ		1	

## [0030]

# 【表4】

	実施例16	実施例17	実施例18	実施例19	実施例20	実施例21	比較例14	比較例15	<b>比較例16</b>
樹脂成分 PC (重量部)	90	80	70	70	90	70	90	86	70
LCP-A (重量部)	10	20	30	30	_	_	10	20	30
LCP-B (重量部)	-	_	_		10	30	_	_	_
亜燐酸エステルA (重量部)	0.1	0. 2	0.3	0.3	0.1	0. 3			
カーボンファイバー (重量部)	12	12	5	6	12	5	12	12	5
ガラスフレーク (重量部)	_	-	_	6	_	_	_	-	_
LCPの融点 (*C)	280	280	280	280	280	280	280	280	280
押し出し温度 (*C)	300	300	300	300	300	300	300	800	300
成形温度 (°C)	300	300	300	300	300	300	300	300	300
射出速度(mm/s)	58. 3	58. 3	58. 3	58.3	58. 3	58.3	58. 3	58. 3	58. 3
LCPの平均7スベクト比(6以上/〇)	0	0	0	0	0	0	×	×	×
曲げ弾性率(kg/cm²)1/32°	82000	106000	79000	90000	86000	98000	63000	67000	50000
アイゾットW/N(kg-cm/cm)	8.9	9.5	6.7	8.9	9. 1	9.3	5.1	4.5	2.4
溶融粘度(poise) at成形温度	2264	1276	852	1141	2177	1523	2337	2511	3297